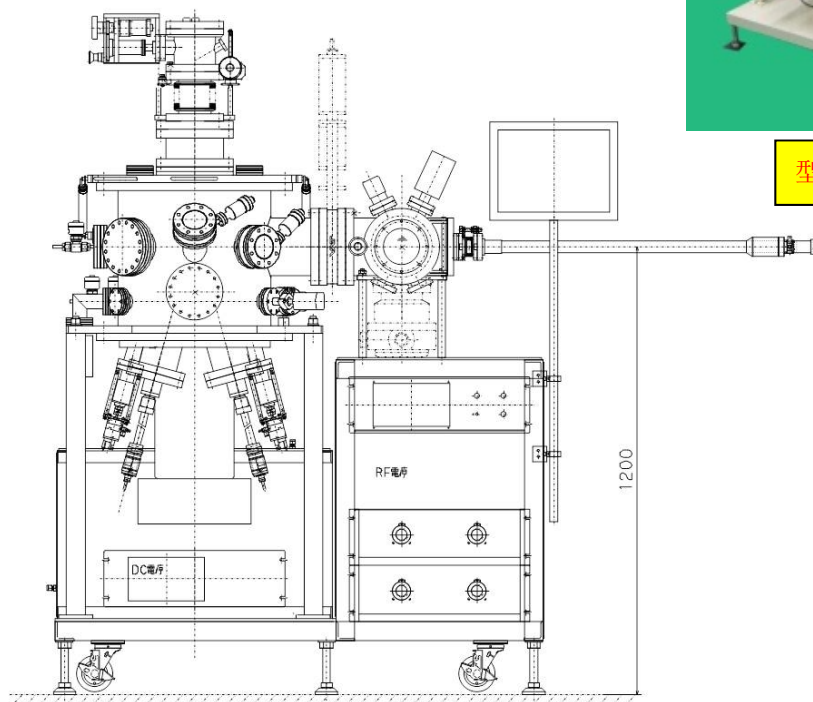


磁控溅射镀膜设备 Sputtering System



型号：ASP-323-1



设备的详细指标及其它型号欢迎来电咨询

设备名称	磁控溅射镀膜设备（标准型）	备注
型号	ASP-323-1（镀膜室+准备室）	
概要	镀膜室尺寸：380 (ID) X400 (H) mm	表面喷砂、水冷
	水冷磁控靶：直径2英寸 3台	配自动挡板
	磁控电源：射频500W、直流800W 各一套	电源功率数量可调整
	衬底：直径3英寸、加热温度高于500	轴向位移台 S=100
	镀膜室真空度：小于 5×10^{-5} Pa	可选择抽气方式
	工作气体：3路、质量流量计控制	根据需要可调整
准备室：真空度小于 5×10^{-5} Pa、传送机构、公用初级泵等		
尺寸及电源	尺寸：150(长)X120(宽)X180(高) CM 电源：单相 220V 60A	

株式会社 アンセイテック ANSEI TECH CO., LTD.
TEL: 06-6707-5888 E-mail: info@anseitech.com